# **TPD-TR3评审表**

平台(技术)名称/版本：

| 项目 | 评审要素 | 检查结果（5分制） | 检查结果说明 | 评审操作指导 | 类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **综**  **合** | 1、各模块的设计是否落实了《设计规格书》中的规格项和性能要求？ |  | *记录发现的与该评审要素有关的的问题、风险以及问题的改进建议、风险分析等。以下同此。* | 根据产品规格形成产品配置，并分解到子系统和模块中。特别关注是否满足满配置时的性能要求是否落实。  此项建议由开发代表/SE/软硬件开发人员/OM 专家给出评审意见 |  | 关联：  Sub-TR：NA  交付件：NA  活动：《需求跟踪表》或相关需求跟踪工具 |
| 2、概要设计里是否落实了EMC、安规、防护、环境、热设计、环保等需求？ |  |  | 产品需求跟踪是否完善？  此项建议由开发代表/SE/软硬件开发人员/专业试验人员/单板工艺设计工程师/结构设计工程师给出评审意见 |  | 关联：  Sub-TR：NA  交付件：NA  活动：《需求跟踪表》或相关需求跟踪工具 |
| 3、概要设计是否落实了配电与电源系统、监控系统和计算机子系统的设计需求？ |  |  | 此项建议由开发代表/SE/软硬件开发人员/机电人员/OM 专家给出评审意见 |  | 关联：  Sub-TR：NA  交付件：NA  活动：《需求跟踪表》或相关需求跟踪工具 |
| 4、概要设计是否满足可服务性需求？是否满足相关OM基线(包括需求基线和设计基线)？ |  |  | 可服务性需求基线是否得到落实？  此项建议由开发代表/SE/FAE/技术支援代表给出评审意见 |  | 关联：  Sub-TR：NA  交付件：NA  活动：《需求跟踪表》或相关需求跟踪工具 |
| 5、概要设计是否满足可生产性需求？ |  |  | 需要考虑制造和测试过程。  此项建议由开发代表/SE/制造代表/测试经理给出评审意见 |  | 关联：需求跟踪表 或相关工具 |
| 6、硬件和软件的集成方案是否考虑好？ |  |  | 概要设计中必须功能合理地分解到硬件、软件模块中。 |  |  |
| 7、各子系统的功能分配是否合理？ |  |  |  |  |  |
| 8、各子系统的功能特性是否可验证？ |  |  |  |  |  |
| 9、设计过程中发现的缺陷是否得到解决或制定经过批准的解决计划？ |  |  | 必须记录所有的问题，并依此形成改进计划，然后组织对问题及其改进计划的评审，进行风险分析，形成规避措施。上述内容均记录在评审报告中。  必须更新风险评估和管理表单。 |  |  |
| 10、TR2～TR3之间各sub-TR的评审报告是否可以接受？ |  |  | sub-TR根据各子流程（譬如：CMM、HCMM等）中的定义获得， |  |  |
| 11、有否解决可能影响后续的技术实现的关键技术？ |  |  | 建议由SE汇总给出评审意见 |  |  |
| 12、HLD、设计规格、测试与验证计划是否置于受控更改状态下？ |  |  | 建议由产品CMO给出评审意见 |  |  |
| 13、HLD是否满足标准策略，并制定详细的标准工作计划？ |  |  | 根据《产品标准策略》评估，并制订详细的《产品标准工作计划》。 |  | 关联：  Sub-TR：产品标准策略、产品标准工作计划  交付件：NA  活动：NA |
| 14、是否完成了《内部平台与技术规范》的制定并评审通过？《内部平台与技术规范》是否遵循已有的技术标准或技术发展趋势？ |  |  | 建议由开发代表、SE发表意见。 |  |  |
| **硬**  **件** | 15、单板的模块之间的功能划分是否合理？ |  |  | 建议由SE汇总给出评审意见 |  |  |
| 16、是否落实了《共用硬件与软件使用计划概要》中的相关计划？是否刷新了《共用硬件与软件使用计划概要》？ |  |  |  |  | 关联：  Sub-TR：NA  交付件：《共用硬件与软件使用计划概要》  活动：NA |
| 17、本产品的单板方案是否落实了与相关产品总体设计方案的适应性？ |  |  | 要关注可能应用此单板或与此单板有对接关系的产品的总体方案，以达成单板共用或组网对接。 |  |  |
| **软**  **件** | 18、各软件项目的需求分解分配是否充分映射产品设计规格软件部分？ |  |  |  |  |  |
| 19、软件子系统的结构是否具有可扩展性?是否具备持续扩展的能力？ |  |  | 建议由SE汇总给出评审意见 |  |  |
| 20、主机和网管接口定义是否文档化及其所有修改是否通过评审？主机和网管接口是否符合公司/产品线的接口定义标准和规范？ |  |  | 接口指各类协议的格式、内容和约定，包括：MIB、MML报文格式、告警清单、错误码等)。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **测**  **试** | 21、HLD和相应的设计规格是否满足可测试性需求？ |  |  |  |  | 关联：  Sub-TR：NA  交付件：NA  活动：《需求跟踪表》或相关需求跟踪工具 |
| 22、是否每一条可测试性需求规格都形成了概要设计项？是否每一个概要设计项都包含有可测试性设计？ |  |  | 这里主要指观察点和控制点 |  | 关联：  Sub-TR：NA  交付件：NA  活动：《需求跟踪表》或相关需求跟踪工具 |
| **结**  **构** | 23、结构设计方案是否满足工业设计的要求？ |  |  |  |  | 关联：  Sub-TR：结构设计方案  交付件：NA  活动：NA |
| **工**  **艺** | 24、在结构设计方案、单板总体设计方案、装备总体方案中是否考虑了工艺的要求？ |  |  | 检查结构设计方案、单板总体设计方案、装备总体方案的评审中工艺要素项的达成情况。 |  |  |
| 25、在概要设计中是否考虑了器件的工艺需求和约束？ |  |  | 根据各单板总体方案的sub-TR结论提取证据 |  |  |
| 26、新工艺技术开发需求是否已提交相关部门开发？ |  |  | 工艺技术开发项目已通过立项评审并计划在TR4前完成. |  |  |
| **装**  **备** | 27、所有生产测试的可测试性设计规格是否得到落实？ |  |  |  |  | 活动：《需求跟踪表》或相关需求跟踪工具 |
| **数**  **据** | 28、计划阶段所要求归档或基线化的技术文档是否已归档或基线化？ |  |  | 通过CMO输出：已归档的文档清单  所有计划阶段输出的文档必须在PDCP前完成 |  |  |
| **资**  **料** | 29、资料项目计划是否已通过Review并归档到配置库？ |  |  | 资料项目计划包括：1. 交付件清单，2. 项目关键交付时间点，3. 质量目标等。 |  |  |
| 30、资料需求跟踪矩阵是否已归档到配置库？ |  |  | 可根据UCD分析方法进行分析 |  |  |
| **CAD/SI** | 31、单板关键器件仿真模型是否齐备？ |  |  | 建议咨询本产品新开发单板的SI工程师 |  |  |
| 32、概要设计过程中是否进行了信号完整性仿真？ |  |  | 建议咨询本产品新开发单板的SI工程师 |  |  |
| 33、是否分析了单板物理实现的可行性？ |  |  | 建议咨询本产品新开发单板的SI工程师 |  |  |
| 34、是否有背板典型电路的设计重用？ |  |  | 建议由中央硬件部的评审专家给出评审意见 |  |  |
| **UCD** | 35、用户交互设计是否经过用户验证？可用性需求是否得到满足？达成可用性目标是否存在风险？ |  |  | 通过原型把交互设计可视化，并且由用户在使用场景中进行评估演练。  将交互设计文档化，输出用户交互设计规格。由UCD工程师给出评审意见 |  | 关联：  Sub-TR：NA  交付件：用户交互设计规格  活动：NA |
| 36、是否关闭用户评估发现的问题？ |  |  | 根据CHARTER中可用性问题关闭比例要求，关闭用户评估发现问题。由UCD工程师给出评审意见 |  | 关联：  Sub-TR：NA  交付件：NA  活动：NA |
| **目标成**  **本管理** | 37、是否考虑优化设计（器件兼容性设计、多家选型等）? |  |  |  |  |  |
| 38、是否对成本进行分析? 是否测算单板/结构/配电的成本情况、测算典型配置成本并评估成本达成情况? |  |  | 包括单板成本、产品关键器件成本、结构件和电缆成本、配电成本报废回收处理成本的分析  由SE给出评审意见  财务代表负责检查 |  |  |
| 39、是否明确重点降成本对象? |  |  | 建议由SE汇总给出评审意见 |  |  |
| 40、是否考虑部分模块、特性或某个开发阶段进行委托开发？被委托方是否通过资质认证？ |  |  | 建议由SE汇总给出评审意见  I |  |  |
| 41、是否考虑合作开发的成本以及后续的维护方式和维护成本？ |  |  | 建议由SE汇总给出评审意见 |  |  |
| **采购** | 42、概要设计中所显现出来的对关键物料的新需求是否邀请Sourcing Team进行评审？ |  |  | 建议由采购代表给出评审意见 |  |  |
| 43、TR2上确定的对关键物料的新供应商的认证是否完成？ |  |  | 建议由采购代表给出评审意见 |  |  |
| **信息安全** | 44、系统内的模块之间的接口是否简洁、清晰，模块调用是否可采用OBJ、Lib文件或扣板的形式？ |  |  | 建议由SE汇总评审意见 |  |  |
| 45、对已经购买来进行集成的软件及开发工具是否有安全性检查? |  |  | 如防止木马或后门等  建议由SE汇总评审意见 |  |  |
| 46、开发过程中，选用的芯片、软件外购件所需要的供应商的支持是否违反公司安全规定？ |  |  | 如需要提供机密信息或需要供应商到实验室支持  信息安全白皮书的相关见《信息安全策略和标准》 |  |  |
| 47、模块调试方案中是否违反公司保密规定？ |  |  | 如移动存储介质，借用公网做系统测试，使用黑客软件做测试等  建议由SE汇总评审意见 |  |  |
| 48、使用的开发工具是否兼容公司标准的IT平台？ |  |  | 如兼容公司的Norton等防病毒软件 |  |  |
| 49、模块设计的后门是否安全，以免被轻易获取系统性能、缺陷等信息？ |  |  |  |  |  |
| 50、系统的设计需求是否有抗反向工程的措施? |  |  | 如模块封装、抗反编译等 |  |  |
| 51、检查文档密级的设置是否符合公司信息安全规定? |  |  | 参见IPD《IPD文档密级清单》《IPD产品文档访问控制表》  此项建议由CMO给出评审意见 |  |  |
| **评 审要素设置说明** | “检查结果”栏填写检查者给出的评审对象对该要素满足的程度（5分制）：  5分－优秀，完全合格，4分－良好，完成质量较好，非主要部分还有少量改进的余地，3分－合格，达到要求，主要部分没有缺陷，次要部分存在错误或不足，2分－待改进，主要部分存在缺陷，1分－差，多数达不到要求，0分－很差，完全没有考虑或方向性错误，NA－本产品不涉及  在评审表模板中，“备注”栏给出的是关联关系，指引检查者查找证据，在具体检查时，检查者的检查意见填写在“备注”栏。  TR3评审重点关注各sub-TR遗留问题和各模块概要设计的匹配问题。  每一条要素如果有问题，需要进行记录，并制定相应的行动计划，问题和行动计划必须经过评审并进行相应地风险分析，制定风险地规避措施。所有的问题、行动计划和风险分析均须列入评审报告中。（在项目的风险管理表单中维护）。  考虑到技术选择的相关性，TR1~4评审要素表未按角色分类，评审专家可充分对自己熟悉的领域发表评审意见。在评审自检时，PQA和SE根据相关性原则将不同类别要素表有针对性的分发给相关领域的评审专家。 | | | | | |
| **签名** | 检查人： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 部门：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |